

鉛フリー対応 金属・セラミック基板用 リフロー装置・RF250 シリーズ

ホットプレート接触加熱式の片面基板用リフローシリーズ！
 雰囲気加熱では良好なプロファイルが得られない金属・セラミック基板に最適！

特徴

基板に直接、熱を与えるホットプレート式のため、雰囲気加熱では困難な金属・セラミック基板(片面)のリフローハンダ付に適しています。

基板がホットプレートの上を直接キャリアバーに押されて(またはテフロンシートに引かれて)スライドするので、放熱性の高い基板も効率良くハンダ付できます。

加熱ゾーン全てがPIDデジタル制御なので高精度で安定した温度プロファイルが得られます。



用途

- 片面(セラミック、ホーロー、金属)基板のリフローハンダ付。
- 放熱器、金属ブロックへのチップ部品ハンダ付。
- ガラエポ高多層板(片面)基板のリフローハンダ付。
- その他、熱容量の大きなワークの加熱作業。



仕様

項目		機種	RF-250	RF-250-8	RF-250N2
対応基板サイズ	最小		25 × 25mm		
	最大		150 × 150mm		
	厚み		0.8 ~ 5.0mm		
	実装高さ		40mm以内		
加熱雰囲気		大気		窒素	
加熱ゾーン		5ゾーン	8ゾーン	5ゾーン	
窒素流量					約20 ~ 100リットル/分
設定温度範囲		0 ~ 500			
電源		AC200V / 220V	AC200V / 220V / 240V		AC200V / 220V
消費電力		6KW / 8.3KW	13.6KW		6KW / 8.3KW
外形寸法		(W)1,680 × (D)550 × (H)391mm	(W)2,370 × (D)550 × (H)620mm	(W)1,680 × (D)550 × (H)1,070mm	
重量		120kg	181kg		170kg

窒素(N2)5ゾーン加熱タイプ:
RF-250N2



ゾーン構成

